

仕 様 書

1. 件名

ハイブリットイメージング用中赤外光源

2. 研究の概要

産業技術総合研究所分析計測標準研究部門では、国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構（NEDO）受託 「経済安全保障重要技術育成プログラム」の一環として、半導体デバイスにおける非破壊的な高分解能 X 線イメージング技術の開発研究を行っている。

3. 装置の概要

本装置は、半導体デバイスを高分解能かつ高感度にイメージングするための X 線・中赤外ハイブリットイメージング装置の一部として運用する中赤外レーザー光源であり、産業応用上不可欠なシリコン半導体のイメージングを可能にする装置である。

4. 装置の基本構成

4-1. ハイブリットイメージング用中赤外光源

5. 基本構成別仕様

5-1. ハイブリットイメージング用中赤外光源

- ① レーザー出力：10W 以上であること。
- ② 中心波長：2910nm であること。
- ③ 運転モード：CW であること。
- ④ ライン幅：1nm 以下であること。
- ⑤ 外寸法：W250mm×D250mm×H100mm 以内であること。

6. 出荷前検査

受注者は、納入に先立って、自己の標準的な検査項目に準じて出荷前検査を実施し、その結果を性能試験成績書として、本装置の納入時に提出すること。

7. 納品確認試験

本装置を搬入、据付、調整の後、調達請求者の立会いのもと、装置が正常に

作動することを確認すること。

8. 納入物品

- 8-1. ハイブリットイメージング用中赤外光源 一式
- 8-2. 取扱説明書 1部（紙媒体）
- 8-3. 性能試験成績表 1部（紙媒体）
- 8-4. 構成品一覧表 1部（紙媒体）

9. 納入の完了

本装置は、「8. 納入物品」に記載された納入物品が過不足なく納入されていることを確認して、納入の完了とする。

10. 納入期限及び納入場所

納入期限：2026年2月27日

納入場所：茨城県つくば市梅園1-1-1

産業技術総合研究所 分析計測標準研究部門

つくばセンター 中央事業所2群 2-1D棟 01115室

11. 付帯事項

- ・ 納入時には、本装置の安全操作及び一般的な保守について説明を行うこと。
- ・ 納入された装置における能力内の使用中に発生した納入の完了後1年以内もしくは運転時間1000時間以内の故障については、その修理、調整等責任をもって無償で行うこと。
- ・ 本仕様書の技術的内容及び知り得た情報に関しては、守秘義務を負うものとする。
- ・ 本仕様書の技術的内容に関する質問等については、調達請求者と協議すること。また、本仕様書に定めのない事項及び疑義が生じた場合は、調達担当者と協議のうえ決定する。
- ・ グリーン購入法適用品の場合は、グリーン購入法に定められた判断基準を満たすものを納入すること。